

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，2024 年 8 月 17 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》，现对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行年度评估，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下：

### 一、聚焦主业业务发展，提升经营质量

在当前半导体行业蓬勃发展且竞争格局日益复杂的大背景下，公司紧密围绕“一主两翼”发展战略稳步前行，以半导体为核心主业，半导体显示和新能源作为重要支撑。公司围绕电子电镀、光刻这两个半导体制造及封装流程中的关键环节，持续深入开展技术攻坚与产业布局，在半导体先进封装、晶圆制造等关键领域均取得了显著进展。

2024 年，半导体行业在历经阶段性调整后，正逐步迈向新的增长周期，但市场竞争依旧极为激烈。在此环境下，公司始终坚定聚焦主营业务，积极优化运营管理模式，深入调整产品结构，大力推进先进封装、晶圆制造等应用领域的技术升级、产品开发以及市场拓展工作。

2024 年，公司实现营业收入 43,218.84 万元，较上年同期增长 20.04%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,347.75 万元，同比增长 2.51%。公司营业收入稳定增长，一方面得益于行业整体需求的复苏，尤其是先进封装相关产品的需求增加，有力拉动了公司产品的销量，公司在先进封装领域表现出良好的增长趋势。另一方面，公司凭借在电镀液及光刻胶等核心产品上的技术优势，持续扩大在客户端的市场份额。

2024 年,公司电镀液及配套试剂销售收入 19,608.44 万元,同比增长 9.67%。电镀液作为芯片制造过程中的关键材料,其技术迭代迅速且市场需求随行业发展不断攀升。公司通过持续研发投入,使电镀液产品性能持续优化,契合了行业对更高精度、更稳定制程的要求,从而实现销售收入稳步增长。

2024 年,公司光刻胶及配套试剂销售收入 9,468.74 万元,同比增长 37.68%。光刻胶作为半导体制造的核心材料,技术门槛极高,近年来随着国内半导体产业自主可控进程的加速,市场对国产光刻胶需求激增。公司在光刻胶研发上取得的一系列突破,有效推动了该板块销售收入的大幅增长。

2025 年,公司将持续在半导体市场深耕拓展、产品研发创新、成本优化控制等多方面协同发力,同时也将通过优化产品结构、拓展市场份额及提升运营效率等举措,进一步巩固行业地位,增强盈利能力与抗风险能力,持续以稳健的业绩表现回馈广大投资者。

## **二、持续加大研发投入,提升科技成果转化和产业化水平**

半导体行业属于典型的技术密集型产业,技术创新与产品升级换代速度极快。公司始终紧跟前沿科技发展趋势,全力推进国产化产业链建设,围绕自身核心技术,基于产业发展动态及下游客户的多样化需求,在不断提升技术与产品能力的同时积极拓宽产品品类,致力于为客户提供更具竞争力的产品组合及整体解决方案。报告期内,公司技术成果转化能力和产品开发效率显著提高,新产品开发能力和技术竞争实力持续增强。

公司坚定加大在高端及“卡脖子”产品方面的研发投入,2024 年研发投入 4,590.17 万元,较 2023 年增长 1,321.39 万元,增长比例 40.42%;研发投入占营业收入的比例为 10.62%,同比增加 1.54 个百分点。公司研发人员增至 78 人,研发人员占员工总人数的比例为 37.68%,研发团队规模的持续扩大为公司技术创新提供了坚实的人才保障。2024 年,公司新增 8 项在研项目,核心聚焦于先进封装及晶圆制造领域的电镀液及光刻胶产品。为保障这些研发项目的顺利推进,公司通过多元渠道持续引进半导体行业的精英人才,组建多支专业研发团队,并配备先进的设施设备。



### （1）电镀液及配套试剂

在电镀液及配套试剂领域，经过十几年的技术沉淀与经验积累，公司凭借关键核心技术，产品性能整体已与国际竞争对手相当，部分指标甚至超越国外竞品。目前，公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现高端应用领域的市场突破。

在先进封装领域，公司先进封装用电镀液及添加剂已实现多款产品量产供应，广泛应用于 Bumping 和 RDL 等工艺。例如，电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技、通富微电实现稳定供应，电镀锡银添加剂已通过长电科技的严格认证并取得小批量订单；先进封装用电镀铜添加剂正处于批次稳定性验证阶段。在晶圆制造领域，公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品目前处于产品认证后期阶段；5-14nm 先进制程的超高纯硫酸钴基液和添加剂在客户端测试进展顺利，晶圆制造铜制程用清洗液已进入量产放大阶段。公司在电镀液产品的技术先进性和市场应用拓展方面处于行业第一方阵。

### （2）光刻胶及配套试剂

- 先进封装负性光刻胶：产品已覆盖多家主流封装厂，市场渗透率持续提升。后续公司将进一步丰富产品型号，以实现全品类覆盖，不断巩固和扩大在该领域的市场份额。

- 晶圆领域 PSPI 光刻胶：公司自主研发的正性 PSPI 光刻胶成功获得主流晶圆厂首个国产化订单，打破了美日企业在该领域的长期技术垄断，成为国内首家实现该材料进口替代的企业。自 2024 年第三季度开始逐步量产，预计 2025 年将逐步实现规模化出货。同时，公司在 PSPI 光刻胶方面同步布局了负性 PSPI 和高

感度化学放大型 PSPI，2025 年计划继续推进 PSPI 产品在先进封装和晶圆厂商的产品认证工作。

- 晶圆 ICA 化学放大光刻胶：在客户端验证测试顺利，部分指标优于国际厂商对标产品，具备良好的市场应用前景。

- OLED 高感光刻胶：用于 OLED 背板阵列黄光工艺制程，在客户端测试中。在 OLED 领域，公司与京东方就未来合作方向及战略规划达成共识并签署合作协议。双方将进一步深化技术合作研发，共同致力于打造创新产品，推动关键材料国产化进程，实现半导体显示材料自主可控，提升产业整体价值。

- 高厚膜 KrF 光刻胶：公司已组建国内外专家团队布局 KrF 光刻胶产品，公司高厚膜 KrF 光刻胶目前处于实验室研发阶段，力求填补国内空白，为提升我国半导体光刻胶技术水平贡献力量。

2025 年，在研发投入方面，公司制定了明确且可持续的投入计划，保持每年研发投入占营业收入的比例超过 10%，确保公司产品的领先性和强竞争力，为公司在市场竞争中赢得持续优势，实现可持续发展目标。为确保研发工作高效推进，公司建立了完善的项目跟踪机制。针对在研项目，设立专门的项目跟踪小组，每周收集项目进展数据，每月进行项目进度评估与总结。重点关注项目关键节点的完成情况，如产品研发过程中的样品试制时间、性能测试通过率等量化指标，力求取得新的技术突破与产品成果，推动公司技术水平与产品竞争力的持续提升。

### **三、持续坚持规范运作，不断提升治理水平**

#### **1、完善公司治理结构，强化内控管理**

公司紧跟法律法规的最新动态，持续完善公司治理和内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。2024 年，以证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机，组织修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度，制定了《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》3 项管理制度。推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学。公司根据相关法律法规要求，已建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、

监督机构和管理层之间权责明确的运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

公司建立了独立董事专门会议及独立董事现场工作等机制，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责，为独立董事履行职责提供所必需的工作条件和人员支持。

2025 年，公司将继续密切关注法律法规和监管政策的变化，结合公司实际情况，稳妥有序地做好新《公司法》及配套制度规则的贯彻落实，进一步完善以公司章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的治理制度体系，持续构建与优化内部控制框架，推动公司治理能力和规范运作水平不断提升。

## **2、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司与实控人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。2024 年公司组织董监高积极参加上市公司治理、法律法规相关培训不少于 3 场，积极参加监管机构组织的会议、座谈及调研等活动，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，促进上市公司高质量发展。公司积极安排“关键少数”参加上交所、地方证监局、行业协会及公司组织的线上线下培训学习，包括董监高初任培训、董事会秘书后续培训、独立董事后续培训，上市公司高质量发展暨监管工作系列培训等。围绕新“国九条”及监管“1+N 系列”等资本市场新法新规，开展监管政策研究学习，关注包括股份减持、退市规则、信息披露、投资者交流等上市公司监管方面的合规注意事项，督促董监高忠实、勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。

2025 年，公司将结合监管政策变化，进一步规范治理层的权责关系，强化公司内部管理和监督机制，不断提升公司治理的水平和质量，强化“关键少数”合规意识和履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

## **四、持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理**

### **1、持续提升信息披露质量**

2024 年，公司严格按照相关法律法规及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司定期报告、

临时公告等重大信息，保障了投资者知情权。公司以投资者需求为导向，在满足强制性信息披露要求的同时，自愿性发布了提质增效重回报行动方案及半年度评估报告。在此基础上，为增强内容的可读性和有效性，公司历次定期报告披露后均采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行了解读，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

2025 年，公司将在严守披露底线的同时，致力于持续提升信息披露质量，强化披露内容的有效性，使所披露信息切实贴合投资者与市场需求，为各方决策提供有力支撑。

## **2、加强投资者关系管理**

2024 年，公司参加“我是股东”走进沪市上市公司活动，组织中小投资者走进公司参观与交流。常态化召开业绩说明会，开展 3 次业绩说明会，并在会后发布《投资者关系活动记录表》，向中小投资者传递调研信息，减少信息不对称。接受特定对象调研 15 次，公司高度重视对中小投资者意见征询和反馈，积极回复上证 e 互动平台问答，设立专人管理并持续接听投资者电话及回复投资者关系邮箱，虚心接受广大投资者对公司生产经营、发展战略等方面提出的宝贵意见和建议。

2025 年，公司将继续遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，在符合相关法律法规的前提下，持续积极为投资者与公司沟通提供便利，通过多渠道、多平台、多方式建立多元化的投资者沟通交流渠道，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，包括积极通过公司管理团队参与的业绩说明会（每年常态化召开 3 次）、上证 e 互动、股东大会、策略会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。切实维护投资者的知情权、监督权。

## **五、重视投资者回报，维护投资者权益价值**

### **1、高度重视投资者回报，与投资者共享公司发展成果**

公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件以及《公司章程》制定了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分

红回报规划》，承诺在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益。

上市以来，公司高度重视投资者回报，在满足分红条件的前提下，积极探索中期分红，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享公司的发展成果。2024 年 6 月，公司完成 2023 年年度权益分派实施，共派发现金红利人民币 13,176,339.15 元（含税）。2024 年 9 月，公司完成 2024 年半年度权益分派实施，共派发现金红利人民币 3,952,901.75 元（含税）

## **2、积极推动股份回购，应用多种市值维护措施**

基于对公司未来发展的信心以及长期投资价值的认可，经公司董事长提议，公司积极推动股份回购，提振投资者信心，并于 2024 年 2 月 26 日经第三届董事会第六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，回购金额 1,000-2,000 万元，回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内。2024 年 5 月 26 日，公司上述回购股份回购期限届满。公司实际回购公司股份 291,073 股，占公司总股本 88,133,334 股的比例为 0.33%，回购成交的最高价为 46.15 元/股，最低价为 28.46 元/股，支付的资金总额为人民币 1,000.91 万元。

2024 年 11 月 19 日经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额 4,000-6,000 万元，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,147,519 股，占公司股本总数的 1.30%，回购成

交的最高价为 45.50 元/股，最低价为 39.53 元/股，支付的资金总额为人民币 5,000.50 万元。

2025 年，公司仍将根据资本市场情况，积极采取相关措施，维护股价稳定，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力公司良性发展。公司将与广大投资者一起，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

公司将持续评估“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将坚持聚焦主业和规范治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强投资者沟通交流；坚持履行社会责任，持续助力行业可持续发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日